

2021年9月22日

各 位

東洋鋼板株式会社

「第4回 名古屋 ネプコンジャパン」出展のお知らせ

東洋鋼板株式会社は「第4回 名古屋 ネプコンジャパン」に出展いたします。

この展示会は、電子機器の多機能化・高性能化を支える世界最先端の電子部品・材料や製造・実装・検査装置が出展されるエレクトロニクス開発・実装展です。

ご来場の際は、ぜひ弊社ブースまでお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

記

- 【会 期】 2021年10月27日（水）～29日（金）
- 【時 間】 10時～17時
- 【会 場】 ポートメッセなごや
- 【入 場 料】 無料（招待券は事前申し込みが必要です）
- 【U R L】 <https://www.nepconjapan-nagoya.jp/ja-jp.html>
- 【出展内容】 研究開発品の展示を予定しています。
 - 高周波 FPC 向け銅張樹脂積層材
 - ・圧延銅箔と液晶ポリマー（LCP）の積層材
 - 高周波・微細配線 FPC 向け銅張樹脂積層材
 - ・キャリア付銅箔と液晶ポリマー（LCP）の積層材
 - ・液晶ポリマー（LCP）への極薄銅めっき材
- 【出展ゾーン】 5G 向け部品・材料ゾーン
- 【小間位置】 15-6

以 上